

部品内蔵技術委員会主催 2022年度第四回公開研究会

主催：EPADs技術調査委員会

◆公開研究会のご案内

部品内蔵技術委員会のEPADs技術調査研究会より2022年度第四回目となる公開研究会を開催します。

今回のテーマは「部品内蔵基板技術を知り、VUCA時代を乗り越える！」となります。部品内蔵基板技術を始めとした技術について、ご紹介いただきます。

開催日時 2023年2月17日 13:30～17:35

開催方式 WEB研究会(Zoom Webinarシステム利用)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:30～13:35 オープニング 司会 EPADs技術調査研究会 主査 藤村迅/幹事 梅本清貴

13:35～14:20 「テーマ 計測技術受託サービスのご紹介」

株式会社メイコー 戸田 光昭 氏

<概要>



様々な分野のお客様に向けて、設計・シミュレーション・測定、基板製造・加工評価・基板解析、信頼性試験・基板分析、実装基板製造・特性評価を提供している。本発表では、①100GHz帯に向けた高周波測定 ②大容量デカップリングコンデンサ内蔵インターポーザ ③高融点はんだ部品内蔵基板の事例を紹介する。

14:20～15:05 「テーマ チップレット設計標準の概況とUCIe1.0仕様について」

コジマイーデザインオフィス 小島 智 氏

<概要>



チップレットは多様なシステム技術を統合するSoC設計手法であり、経済的に最適なプロセスノードの小型シリコンダイを選択し相互接続することで実現する。チップレット設計を可能とする統合SoC設計環境の構築には新たな設計標準が必要であり、この概況とUCIeコンソーシアムが推進する UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express) 1.0 インターコネクタ仕様について述べる。

15:05～15:50 「テーマ 銅コアを用いて部品を内蔵したEC2AMの紹介」

ユニマイクロンジャパン株式会社 中村 岳史 氏

<概要>



部品内蔵基板は、今までは小型化や熱放散性の用途で開発をしていたが、今後は部品を内蔵しない、銅コアでの高放熱性やコプラナリティーを重視した基板の適用も期待されている。本講演では、EC2AMの発展性を中心に述べる。

15:50~16:05 休憩

16:05~16:50 「テーマ 高周波プリント配線板と3Dパッケージを支える材料技術」
株式会社ダイセル 八甫谷 明彦 氏



<概要>

高周波伝送における伝送損失は、主に抵抗損失と誘電損失の低減することが必要であり、これら課題を解決するプリント配線板の低損失材料、および平滑導体と低誘電材料の接着・接合技術を紹介します。また、昨今システムインテグレーション、半導体戦略では不可欠な3Dパッケージを支える導電、絶縁、接着に関わる材料技術についても紹介します。

16:50~17:35 「テーマ p² Pack Power Packaging: Today – Tomorrow – In Future」
Schweizer Electronic AG Thomas Gottwald 氏



<概要>

Packaging of semiconductor components is related to the function and the form factor of an electronic component. Power components need other packages than logic devices. The characteristics of a power electronic device is strongly influenced by it's package. Embedding of power electronic components into PCBs is an alternative to conventional packaging. The speech will cover the low voltage applications, high voltage automotive solutions and will give an outlook into further developments.

参加要項

定員 300名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:15,000円 非会員学生:2,000円 賛助団体会員:5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
*キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員/賛助/非会員の方

※クーポン利用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会
E-mail: info@jiep.or.jp
(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)